

【公報種別】特許法第 17 条の 2 の規定による補正の掲載

【部門区分】第 2 部門第 5 区分

【発行日】平成26年7月31日(2014.7.31)

【公開番号】特開2013-23171(P2013-23171A)

【公開日】平成25年2月4日(2013.2.4)

【年通号数】公開・登録公報2013-006

【出願番号】特願2011-162925(P2011-162925)

【国際特許分類】

B 6 0 R 13/02 (2006.01)

B 2 9 C 65/46 (2006.01)

【F I】

B 6 0 R 13/02 Z

B 2 9 C 65/46

【手続補正書】

【提出日】平成26年6月12日(2014.6.12)

【手続補正 1】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0 0 1 4

【補正方法】変更

【補正の内容】

【0 0 1 4】

前記基材1としては、熱可塑性樹脂からなり、ポリプロピレン（PP）、ポリエチレン（PE）、ポリエチレンテレフタレート（PET）、アクリロニトリル - ブタジエン - スチレン（ABS）、ポリカーボネート（PC）、ポリ塩化ビニル（PVC）、高密度ポリスチレン（HPS）などの樹脂が可能である。前記熱可塑性樹脂のうちの1種のみでも良く、または、2種以上を選択して複合化した熱可塑性樹脂でも良い。

【手続補正 2】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0 0 1 5

【補正方法】変更

【補正の内容】

【0 0 1 5】

前記溶着部材3としては、一般の射出部品が適用可能であり、例えば、クリップ、ブラケット、リフォース、ストライカー、ネット、クッション材（発泡体）などである。また、溶着部材3の材質は、例えば、熱可塑性樹脂からなり、ポリプロピレン（PP）、ポリエチレン（PE）、ポリエチレンテレフタレート（PET）、アクリロニトリル - ブタジエン - スチレン（ABS）、ポリカーボネート（PC）、ポリ塩化ビニル（PVC）、高密度ポリスチレン（HPS）、エチレン酢酸ビニル（EVA）、ポリエステル、ポリアセタール（POM）、ポリアミド（PA）などを適用可能である。

【手続補正 3】

【補正対象書類名】図面

【補正対象項目名】図 3

【補正方法】変更

【補正の内容】

Fig. 1 is a cross-sectional view of a semiconductor device. It shows a substrate 1 with a layer 1a, a layer 5, and a layer 3. A central structure 23 is shown with a top layer 21 and a bottom layer 25. A dimension D is indicated for the height of the central structure 23.